

ICS 77.150.30  
H 62



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14594—2005  
代替 GB/T 14594—1993

---

## 无氧铜板和带

Oxygen-free copper sheets and strips

2005-07-04 发布

2005-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 前 言

本标准是对 GB/T 14594—1993《无氧铜板和带》的修订,修改采用了美国 ASTM F68—1993《电子设备用无氧铜加工材》和日本 JIS H3510—1992《电子管用无氧铜板、带、无缝管、棒和线》标准。本标准规定的无氧铜板和带材主要用于电真空器件,一般用途的无氧铜板材按 GB/T 2040—2002《铜及铜合金板材》的规定执行。

本标准和 GB/T 14594—1993 相比主要作了如下修改:

- 产品的牌号增加了 TU0 的规定;
- 板材增加了 Y<sub>2</sub>(半硬)状态,带材增加了 Y<sub>4</sub>(1/4 硬)和 Y<sub>2</sub>(半硬)状态;
- TU1、TU2 的氧含量由原来的“不大于 0.002%、0.003%”统一改为“不大于 0.001%”;
- 板材的宽度范围由“200 mm~600 mm”改为“200 mm~1 000 mm”,长度范围由“800 mm~1 500 mm”改为“1 000 mm~2 500 mm”;
- 带材的厚度范围由“0.06 mm~1.20 mm”改为“0.05 mm~4.0 mm”,宽度由“20 mm~300 mm”改为“≤1 000 mm”,长度由定尺改为不作规定;
- 将板、带材的厚度允许偏差合二为一。厚度允许偏差按宽度分为四档,厚度也重新进行了分档;
- 板、带材的宽度允许偏差统一按宽度分为三档,并对宽度允许偏差进行了较大幅度的提升;
- 板材的长度允许偏差由原来的“-15 mm”改为按厚度分为二档:厚度不大于 0.8 mm 时,长度允许偏差为+5 mm;厚度大于 0.8 mm 时,长度允许偏差为+10 mm;
- 取消了允许短尺交货的规定;
- 对力学性能中的抗拉强度、伸长率进行了补充,并增加了维氏硬度的规定;
- 对弯曲试验进行了修订;
- 软态产品的晶粒度由原来的“不大于 0.055 mm”改为“0.015 mm~0.050 mm”,并增加了 1/4 硬(Y<sub>4</sub>)状态晶粒度检验的规定;
- 增加了对不同状态电性能的规定;
- 带材的侧边弯曲度由原来的“不大于 4 mm/m”改为按宽度分为二档:宽度不大于 100 mm 时,侧边弯曲度不变;宽度大于 100 mm 时,侧边弯曲度不大于 3 mm/m;
- 板材的不平度由原来的“不大于 20 mm/m”改为按厚度分为三档:厚度不大于 1.5 mm 时,不平度不大于 15 mm/m;厚度大于 1.5 mm~5.0 mm 时,不平度不大于 10 mm/m;厚度大于 5.0 mm 时,不平度不大于 8 mm/m;
- 取消允许存在的表面质量缺陷,仅规定“不允许有影响使用的缺陷”。

本标准代替 GB/T 14594—1993。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由洛阳铜加工集团有限责任公司、上海金泰铜业有限公司、白银公司西北铜加工厂负责起草。

本标准主要起草人:孟惠娟、程万林、黄春梅、邵胜忠、赵莉、周新珉、张健、文继友。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 14594—1993。

# 无氧铜板和带

## 1 范围

本标准规定了无氧铜板和带的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。  
本标准适用于电子工业部门作电真空器件用高精度无氧铜板、带材。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法
- GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法
- GB/T 351 金属材料电阻系数测量方法
- GB/T 4340.1 金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法
- GB/T 5121 铜及铜合金化学分析方法
- GB/T 5231 加工铜及铜合金化学成分和产品形状
- GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存
- YS/T 335 电真空器件用无氧铜含氧量金相检验法
- YS/T 347 铜及铜合金平均晶粒度测定方法

## 3 要求

### 3.1 产品分类

#### 3.1.1 牌号、状态、规格

板带材的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

表1 牌号、状态和规格

牌 号	供 应 状 态	形 状	规格/mm		
			厚度	宽度	长度
TU0、TU1、TU2	M(软)、Y <sub>2</sub> (半硬)、Y(硬)	板	0.4~10.0	200~1 000	1 000~2 500
	M(软)、Y <sub>4</sub> (1/4 硬)、Y <sub>2</sub> (半硬)、Y(硬)	带	0.05~4.0	≤1 000	—

注:经供需双方协商,也可供应其它状态、规格的产品。

#### 3.1.2 标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、规格和标准编号的顺序表示。标记示例如下:

示例1:

用TU2制造的、M状态、厚度为0.5 mm、宽度为200 mm的带材标记为:

带 TU2M 0.5×200 GB/T 14594—2005

示例2:

用TU1制造的、Y<sub>2</sub>状态、厚度为5 mm、宽度为1 000 mm、长度为2 000 mm的板材标记为:

板 TU1 Y<sub>2</sub> 5×1 000×2 000 GB/T 14594—2005